Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!

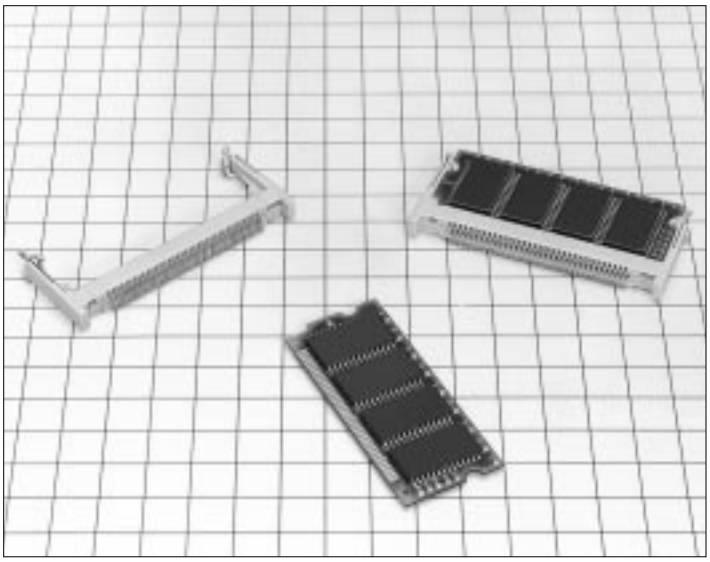
Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832
Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com
Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書 / 参考図にてご確認下さい。
RoHS非適合製品については生産中止予定です。RoHS対応製品につきましては、RoHS対応品検索して頂くか、弊社営業担当へご相談下さい。

72PIN Small Outline DIMMソケット

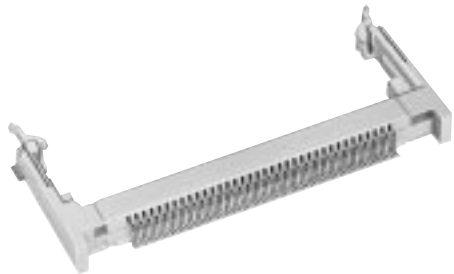
SX1シリーズ



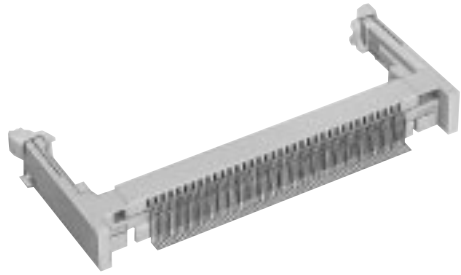
スタック高さのバリエーション

- 低背タイプ(スタック高さ：4.0mm)

- 標準タイプ(スタック高さ：5.5mm)



- 高背タイプ(スタック高さ：8.0mm)



容易なモジュール基板の着脱操作

■ 特長

1 . 72PIN Small Outline DIMMソケット

SX1シリーズはJEDECで標準化された『Small Outline DIMM』に適合する0.635mmピッチ水平SMTタイプソケットです。
従来のDRAM SIMMソケット72極と比較して約半分の大きさになります。
倍密度(両面)対応のため、モジュール基板の高機能化、高密度化が可能です。

2 . スタック高さのバリエーション

スタック高さに3種類のバリエーションを用意しています。
(右の写真をご参照ください。)

3 . モジュール基板の着脱が容易

モジュール基板を斜めより差し込み、下方に押し込むだけのワンタッチ装着が可能です。
また、ラッチを左右に外すとモジュール基板が起き上がる構造で、着脱が容易です。
尚、低背タイプは、両端のラッチを上から押すとラッチが左右に外れる機構を採用して着脱を容易にしています。

4 . 高性能を実現

挿入する時の確実なワイピング効果と、独自の圧延面コンタクトによる高性能を実現しています。

5 . クリック感がある着脱操作

独自のモールドツインラッチにより、クリック感があり、着脱操作性に優れます。

■ 用途

パソコン、OA機器、計測器、通信機器、FA、ゲーム用機器等。

■ 製品規格

定格	使用温度範囲	-55℃ ~ +85℃	保存温度範囲	-55℃ ~ +85℃
	電圧	AC125V		
	電流	0.5A		

項　　目	規　　格	条　　件
1. 接触抵抗	35mΩ 以下	100mAで測定する。
2. 絶縁抵抗	1000MΩ 以上	DC 250Vで測定する。
3. 耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと。	AC 250Vの電圧を1分間印加する。
4. 耐振性	1μ s以上の電気的瞬断がないこと。	周波数10 ~ 55Hz（1サイクル、5分）、片振幅0.75mmで3方向各50分。
5. 耐湿性	① 接触抵抗：55mΩ 以下 ② 絶縁抵抗：1000MΩ 以上	温度40± 2℃、湿度90 ~ 95%中に96時間放置する。
6. 温度サイクル	① 接触抵抗：55mΩ 以下 ② 絶縁抵抗：1000MΩ 以上	温度　-55→+5 ~ +35→+85→+5 ~ +35℃ 時間　30→10 ~ 15 → 30→10 ~ 15分 を5サイクル試験する。
7. 挿抜寿命	接触抵抗：55mΩ 以下	挿抜30回
8. 塩水噴霧	接触抵抗：55mΩ 以下	濃度5%の塩水、48時間放置する。

■ 材質

部 品 名	材　　質	処　　理
端　　子	りん青銅	部分金めっき
絶 縁 物	PPS樹脂（UL94V-0）	―――
固定金具	りん青銅	はんだめっき

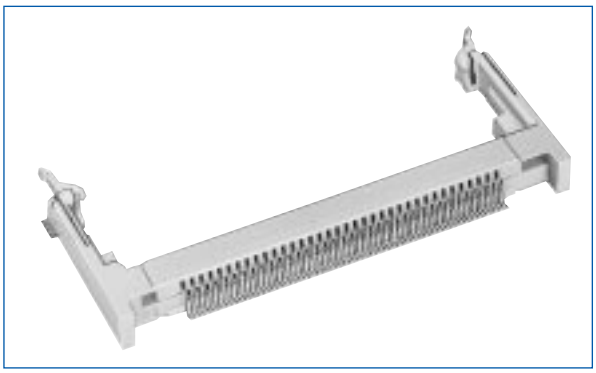
■ 製品番号の構成

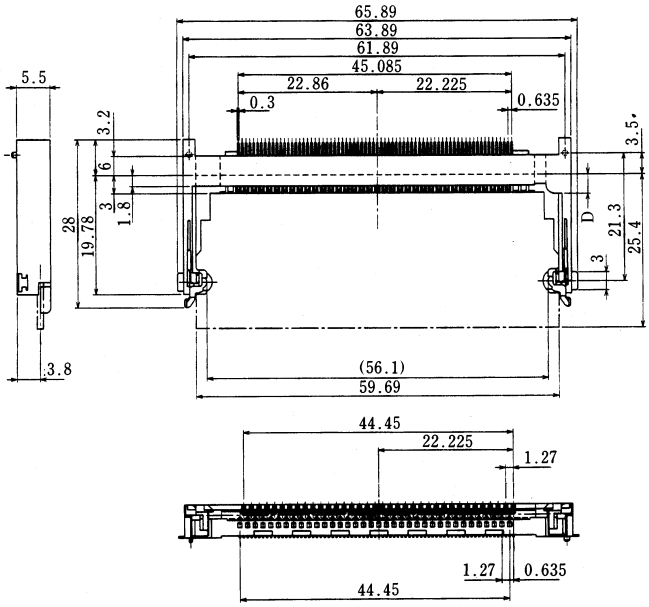
SX1 C A - 72 S - 0.635 SH

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

❶シリーズ名称：SX1	❹極数：72極
❷スタック高さ B：標準タイプ（高さ5.5mm） C：高背タイプ（高さ8.0mm） E：低背タイプ（高さ4.0mm）	❺端子の種別：雌端子
❸DIMM対応キー 無印：3.3Vタイプ A　：5Vタイプ	❻端子間ピッチ：0.635mm
	❼端子形状 SH：SMTタイプ

■ 標準タイプ

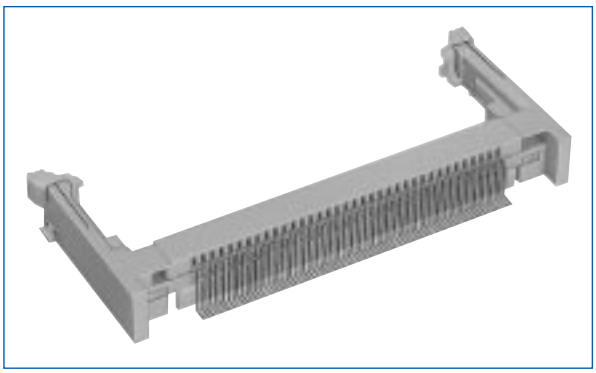


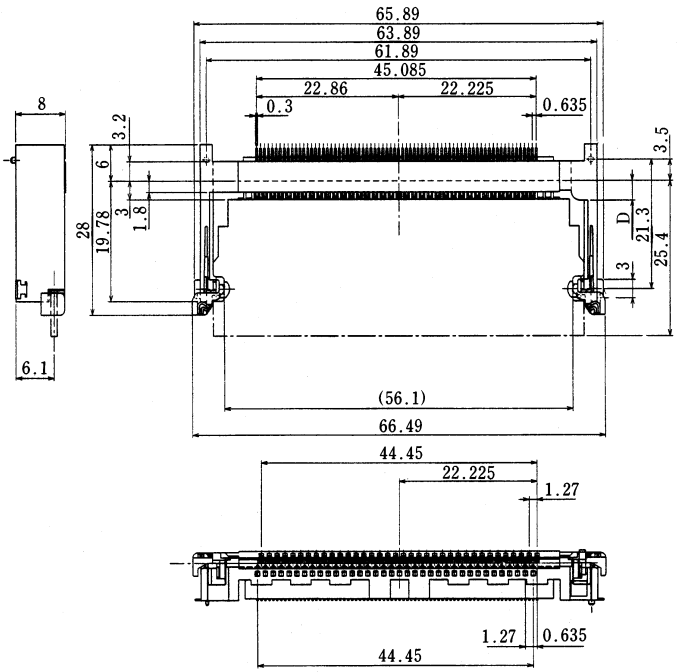


	製　品　番　号	HRS No.	極数	キー	D	備　　考
※	SX1B-72S-0.635SH	CL530-0018-9	72	3.3Vタイプ	3.1	端子：部分金めっき
※	SX1BA-72S-0.635SH	CL530-0019-1		5Vタイプ	5.4	端子：部分金めっき

（注1）※ 印品には、マガジン梱包品も用意しております。マガジン梱包品をご指定の際には、製品番号の末尾に（20）と追記ください。（販売単位：20個1組）
（注2）キーの3.3Vと5Vは、Small Outline DIMMのキーに対応します。

■ 高背タイプ

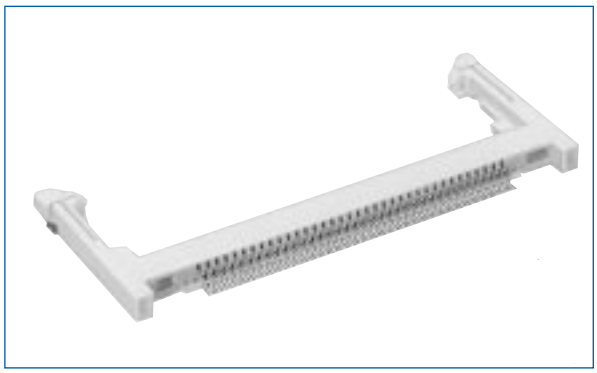


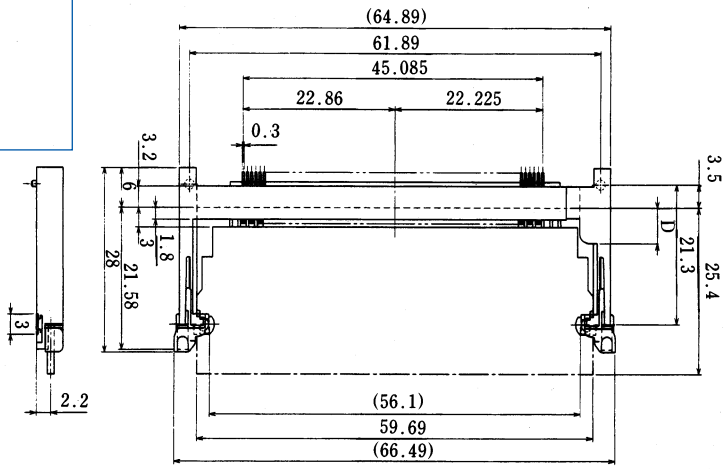


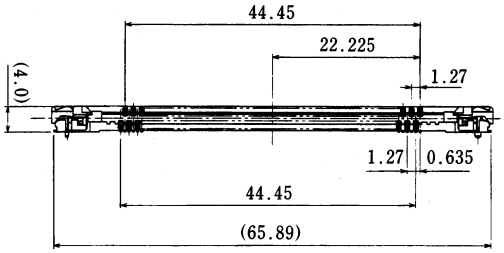
製　品　番　号	HRS No.	極数	キー	D	備　　考
SX1C-72S-0.635SH	CL530-0003-1	72	3.3Vタイプ	3.1	端子：部分金めっき
SX1CA-72S-0.635SH	CL530-0004-4		5Vタイプ	5.4	端子：部分金めっき

（注2）キーの3.3Vと5Vは、Small Outline DIMMのキーに対応します。

■ 低背タイプ





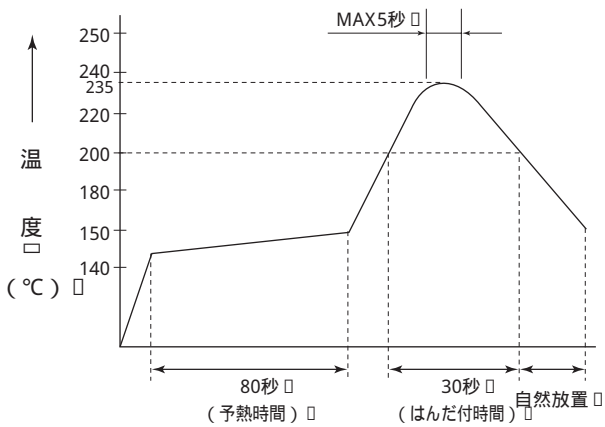


製　品　番　号	HRS No.	極数	キー	D	備　　考
SX1E-72S-0.635SH	CL530-0006-0	72	3.3Vタイプ	3.1	端子：部分金めっき
SX1EA-72S-0.635SH	CL530-0007-2		5Vタイプ	5.4	端子：部分金めっき

(注) キーの3.3Vと5Vは、Small Outline DIMMのキーに対応します。

◆実装温度プロファイル(推奨)

● IRリフロー： 右図推奨温度プロファイル
(2回リフロー迄)



● 手はんだ付け

コテ先温度：300℃± 10℃　手はんだ付け時間：最大3秒

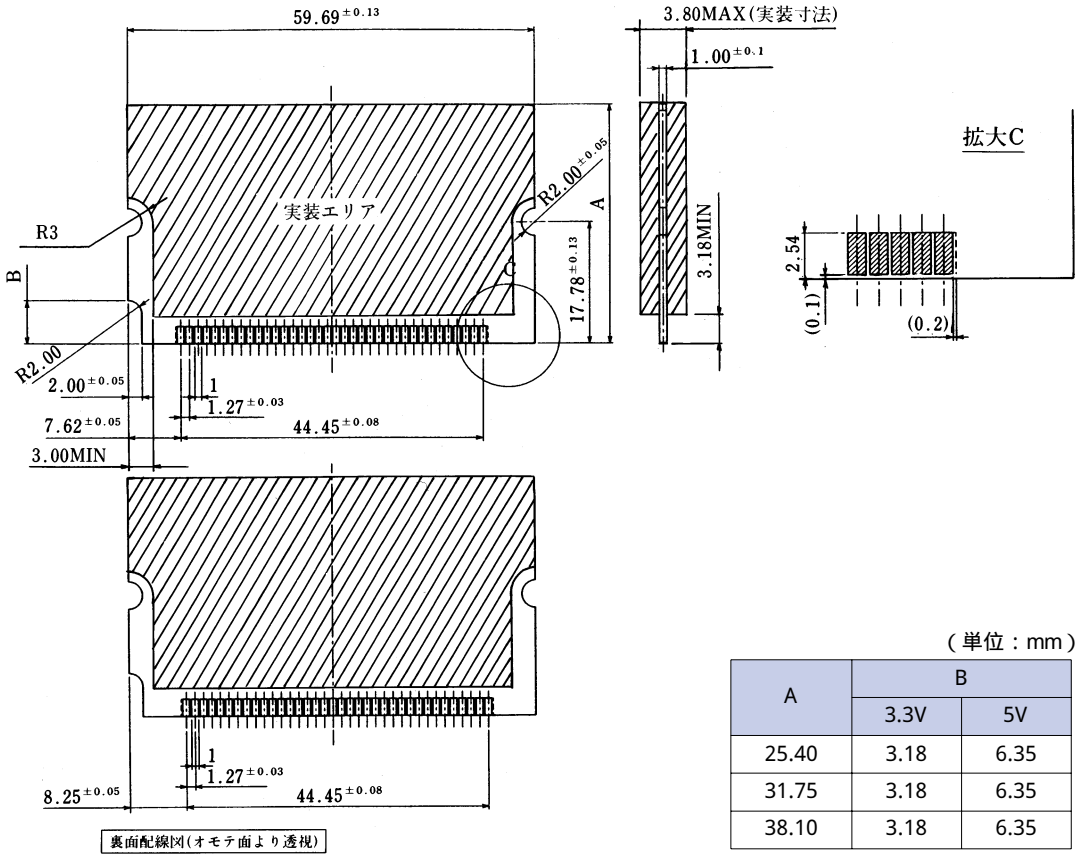
(ご注意)
温度プロファイルは推奨です。クリームはんだの種類・量により、多少変わる可能性があります。

● 設定条件について(参考)

○ 基板
寸法：110× 85× 1.6(mm)
材質：ガラスエポキシ(グレード：FR-4)

○ クリームはんだ
組成：63Sn/ 37Pb (フラックス含有量11wt%)
メタルマスク厚：0.15mm

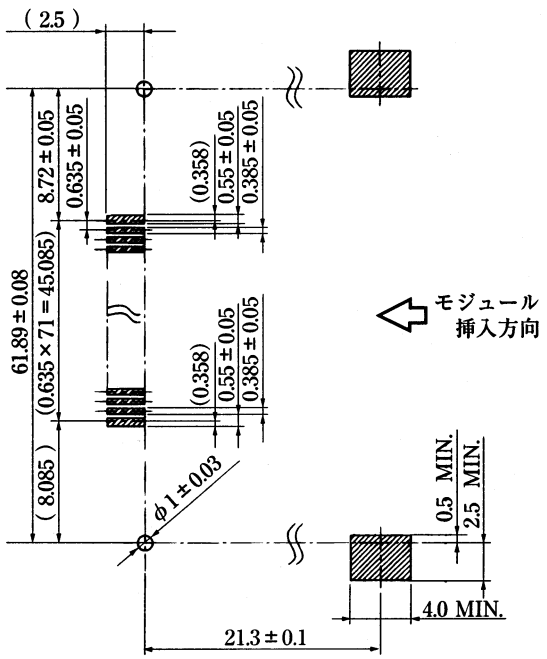
◆推奨モジュール基板寸法図



(単位 : mm)

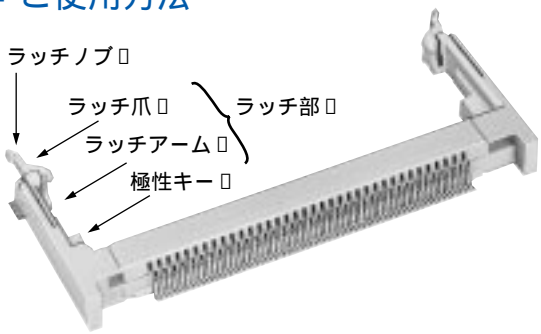
A	B	
	3.3V	5V
25.40	3.18	6.35
31.75	3.18	6.35
38.10	3.18	6.35

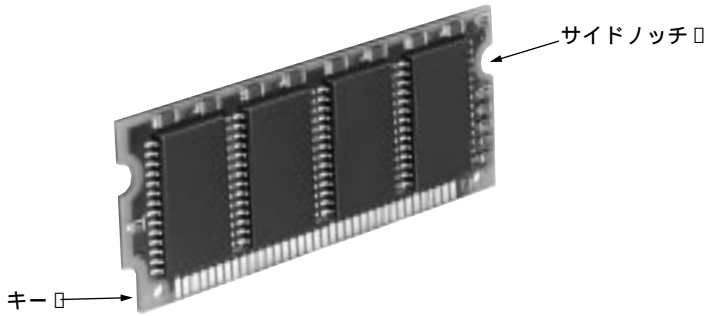
◆推奨ランドパターン寸法図(実装面側)



(単位 : mm)

■ ご使用方法





【基板装着方法】

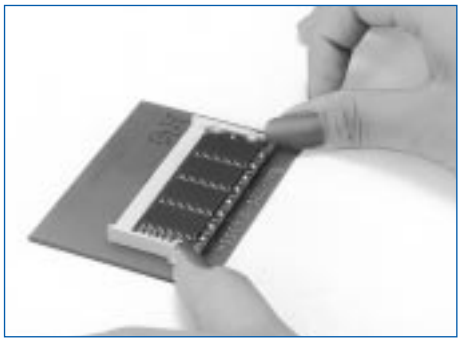
①ソケットの極性キーと基板のキーを同一方向に合わせます。
②基板を斜めに挿入します。尚、基板は20°~30°位の角度から開口部に沿って平行にし、先端がソケットの底に当たるまで軽く挿入します。途中で止めると不完全挿入になります。
③基板の位置がずれない様にソケットの底に平行に押し当てながら、基板サイドノッチ上方を押し下げ、ソケットの両端のラッチを止めます。基板がラッチ爪の上部先端を越え「パチン」というクリック音がするまで押して手を離します。
これで嵌合が完了します。この時の力は電気製品のスイッチを入れる程度ですので、それ以上の力で押す必要がある場合は、基板の挿入向きと深さなどの違いを確認し、押し込みし直してください。

【基板引き抜き方法】

スタンダードタイプ、高背タイプ
ソケット両端のラッチノブに親指の爪等を掛けて左右に押し広げてラッチを解除し、おき上った角度に沿ってそのままの状態で基板を引き抜いてください。
低背タイプ
両端のラッチ部トップを指で下方に押してラッチを解除し、そのままの状態で基板を引き抜きます。

（ご注意）

①「ラッチ部」は、十分な強度を持っていますが、「ご使用方法」以外の操作や力が加わったりモジュール基板が起き上がった状態で、さらに力を加え続けますと、破損する恐れがありますので、ご使用方法を遵守してください。
②JEDECの『Small Outline DIMM（Dual Inline Memory Module）』に準拠する設計になっています。推奨モジュール基板以外や実装品をDRAM等メモリIC以外でご使用の場合は、振動、その他により異常が起きる恐れがありますので、各々についてご確認ください。
③上図の例はSX1Bを示します。
④推奨モジュール基板のパッドおよび先端部の鋭い角等は、コンタクトに異常を与える原因になる場合がありますので各推奨寸法範囲で、タイバーはセンターラインからのオフセット、（0.1mm）等の内側パッド設定、鋭い角やバリの除去等を推奨します。
⑤モジュール基板の外形端面は凹凸、両端面の面取り等を設けず、推奨寸法を遵守してください。
⑥実装基板、及び筐体取り付け時、そり、たわみ等が生じる場合は、過負荷によりはんだ接続部、他、強度等が変化する場合がありますので、個別にご確認ください。

基板装着方法

基板引き抜き方法